

ネプコンジャパン2019

第20回半導体・センサパッケージング技術展出展

1 期間・会場

開催期間 2019年1月16日～1月18日(3日間)

会場 東京ビッグサイト

東光高岳ブース 東展示場 3ホール E27-22

2 概要

本展示会は、半導体／実装・検査機／LED・レーザ／電子部品・材料にかかわるあらゆる製品・技術・サービスの会社が一堂に出展するアジア最大級の「エレクトロニクス専門展」である。

3日間の来場者数は、会場全体で116,244名となり、前年より1,864名増と大盛況となった。

光応用検査機器事業本部では、会場へ向かう通路上に社名広告を出し、半導体業界での会社の認知度向上を図った。

東光高岳ブースでは、新規受注を目的に、小型温度可変反り検査装置 HVI-8000C の実機展示およびプレゼンテーション資料にて PR を行った。

東光高岳ブースにも多数のお客さまにお越しいただいた。50社以上のお客さまからお問合せをいただき、ご好評をいただいている。



図1 通路上社名広告

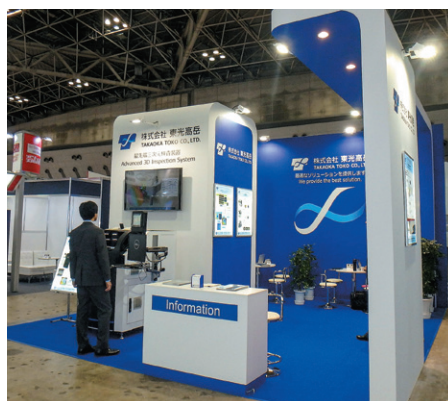


図2 東光高岳ブース



製品特長

- 小型 & 低価格
- 共焦点光学系による高精度計測
- パンプ除去・塗装不要
- 冷却機能 $\sim -55^{\circ}\text{C}$
- 高速対流加熱 $3^{\circ}\text{C}/\text{sec}$

図3 小型温度可変反り検査装置 HVI-8000C



図4 製品説明